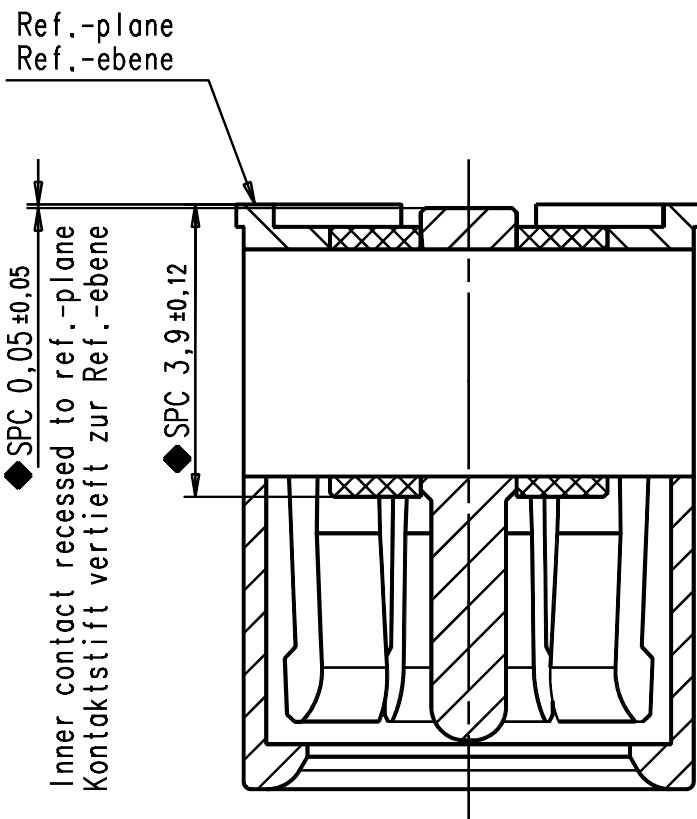
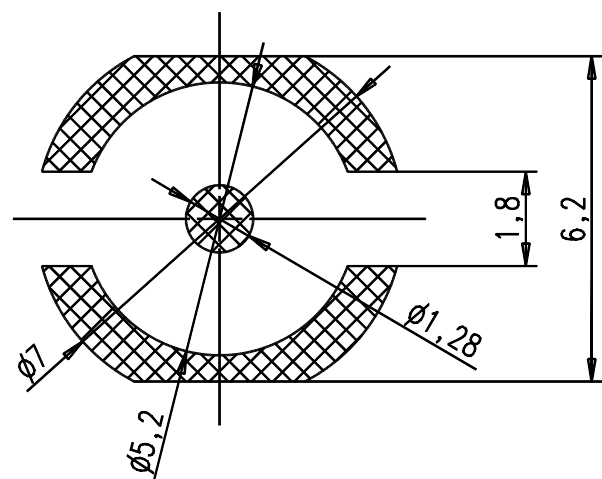
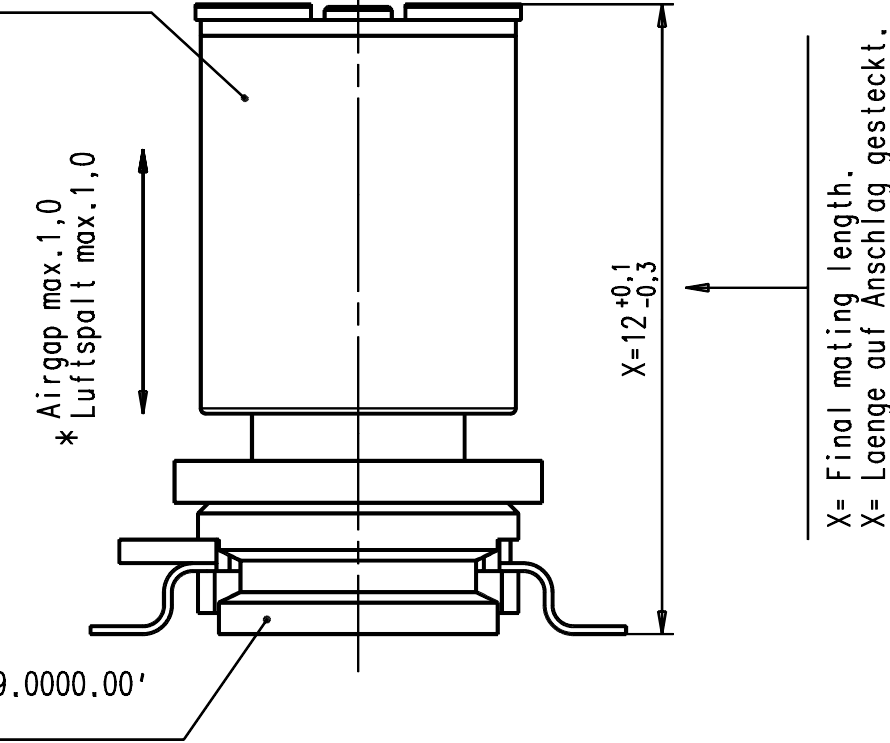


PCB-LAYOUT



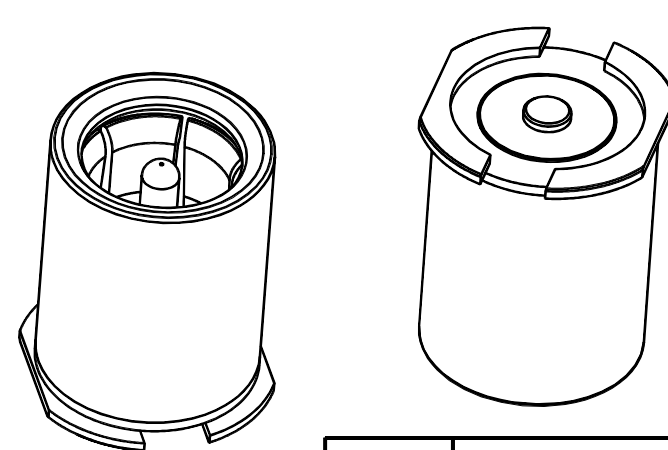
3384.99.0000.008
SMT Plug



2421.99.0000.00'
Switch

* Airgap max. 1,0 mm:
i.e. at mating length < 1,0 + X (12+0,1/-0,3)
no deterioration of RF performance
Luftspalt max. 1,0 mm:
D.h. bei Stecklaenge < 1,0 + X (12+0,1/-0,3)
keine Verschlechterung der HF-Eigenschaften.
**=> Useable working height 12,1 up to 12,7
Nutzbare Arbeitshoehe 12,1 bis 12,7**

◆ = Nachweis Prozessfaehigkeit / Process capability verification
SPC = Fuehren Qualitätsregelkarte / Quality control chart



Einzelteil / Part	Werkstoff / Material	Oberflaeche / Surface
Federkorb /Spring basket	PS2	2µm Pallatronic S
Gehaeuse / Housing	CuZn	Optalloy 2µm
Innenleiter / Centre Contact	CuZn	0,4µm Au over 2µm Ni
Isolierteil / Insulator	PTFE	

IMS CONNECTOR SYSTEMS					general tolerance ISO 2768 mH	scale: 10:1 (7:1)
078/03	g	tol. changed	21.02.03	Maier	date	name
Entwurf	f	reworked	11.11.02	Maier	generate	28.09.01 Berger
Entwurf	e	FMEA-optimized	07.05.02	Maier	checked	
Entwurf	d	Luftspalt ergaenzt	25.01.02	Berger	Norm	
Entwurf	c	Material ergaenzt	10.01.02	Berger	37173	
Entwurf	b	12 war 11,2	29.11.01	Berger		
Entwurf	a	11,2 war 12,5	09.10.01	Berger		
nr.	rev.	alteration	date	name		
						3384.99.0000.008
						Rev. g